



装置型式：MAT-ZAB-8S1M

対応Wfサイズ	φ3"~φ200mm
チャンパー数	1個
チャンパー機能	片面スクラブ・スピン乾燥

LD-UnLD	マニュアル
フットプリント	W1100xD700xH1450mm
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価

### - 装置コンセプト -

LAB使用に適したコンパクトなモデルから300mmウェーハに対応したモデルまでラインナップを取り揃えております。また、お客様のご希望に沿った仕様変更・オーダーメイド、Dry-in / Dry-outが可能なCMP自動装置もご提案いたします。

ケメット・ジャパン株式会社  
千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27  
TEL: 043-301-5408 HP: www.kemet.jp

Kemet Japan Co.,LTD

ケメットジャパン株式会社

# Kemet

## CMP装置カタログ

Kemet Japan Co.,LTD

# Kemet - CMP装置ラインナップ -



装置型式：BC-15CN

対応Wfサイズ	チップサイズ~φ100mm
プラテンサイズ	φ380mm
LD-UnLD	マニュアル



フットプリント	W850xD600xH800mm
ドレスサイズ	φ190mmホイール
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価



装置型式：MAT-ARW-681MS II

対応Wfサイズ	φ3"~φ200mm
プラテンサイズ	φ610mm
LD-UnLD	マニュアル



フットプリント	W1375xD855xH2200mm
ドレスサイズ	φ100mmスイープ
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価



装置型式：MAT-ARW-461M

対応Wfサイズ	φ3"~φ150mm
プラテンサイズ	φ400mm
LD-UnLD	マニュアル



フットプリント	W700xD600xH1800mm
ドレスサイズ	φ195mmホイール
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価



装置型式：MAT-ARW-8C1MS

対応Wfサイズ	φ3"~φ300mm
プラテンサイズ	φ810mm
LD-UnLD	マニュアル



フットプリント	W1800xD1100xH2250mm
ドレスサイズ	φ100mmスイープ
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価